

SILK PRINT FOR PARTS SIDE

PARTS SIDE

INNER LAYER (3rd LAYER)

SILK PRINT FOR SOLDERING SIDE

INNER LAYER (2nd LAYER)

SOLDERING SIDE

THROUGH HOLE FOR PARTS SIDE

MARK	DIAGRAM	HOLE	MEMO
⊙	φ 0.3	TH	
○	φ 0.5	TH	
⊘	φ 0.7	TH	
⊗	φ 0.8	TH	
⊙	φ 0.7	NTH	
⊗	φ 3.04	NTH	

SPECIFICATION FOR PCB

・PCB No.

: RKP-93125P

・Material

: Glass epoxy

・Thickness

: 1.0mm

・Layer number

: 4

・Thickness copper film

: Surface 35um,Inner 35um

・Copper thickness of the via's

: 35um above.

・Minimum conductor width

: 0.3mm

・CTI

: 100 above

All drawings are view of parts side

SCALE 2:1

注 記 NOTES

改版回数 REV. 0

承認 APPROVED 山田和則

総頁数 PAGES 1

検 討 CHECKED 小野圭

改版担当者 REV. BY

製 図 DRAWN 木村司

改版日 REVISED

作成日 DATE 2024.2.21

名 称 NAME GPS PCB

EAGLE3

図 番 DWG. NO.

E 3 - 6 9 9 1 - 6 5 1 7 - 4 0 - 0 1 A

RIKEN KEIKI

理研計器株式会社

機密情報 / CONFIDENTIAL